

環境調和型先端実装技術成果報告会 2014

- 主 催：実装技術標準化専門委員会
- 担当部署：知的基盤部
- 参加者数：約100名

概 要

JEITA / 実装技術標準化専門委員会では、1997年から継続して鉛フリー化活動に取り組み、本報告会を通じて成果の普及に努めてきました。

また、JEITAの領域に留まらない業界横断的な課題については、国家プロジェクトとして取り組み、その成果の国際標準への移行状況についても広く周知するようにしています。

今年は、実装領域における3Dモデル活用、プリント基板のランドパターン設計、電子部品の吸湿感度レベル、METIプロジェクト「部品内蔵基板の設計データフォーマットの国際標準化」をはじめ、鉛フリー化関連では、

2013年に終了したMETIプロジェクト「フロー槽材料の長期信頼性に関わる各種特性の評価試験方法に関する標準化」を基にしたフロー槽材料の耐エロージョン性評価試験方法の標準化状況、JEITAプロジェクト「第2世代リフロー用鉛フリーソルダーペーストの標準化」の結果を受けた第2世代低銀系ソルダーペースト標準品の特性、EUのELV（廃自動車）指令の2014年改定の動向等、多岐に亘るテーマについて発表しました。

今、業界が直面している課題やトピックスについて、活発な質疑応答が交わされ、大変有意義なものとなりました。



プログラム

○主催者挨拶

JEITA 実装技術標準化専門委員会 委員長 岡本 正英 氏 (株)日立製作所

○来賓挨拶

経済産業省 商務情報政策局情報通信機器課 電子デバイス一係長 西尾 直美 氏

○「実装領域における3Dモデル活用と標準化活動について」

村田 貴昭 氏 (ソニー(株))

○「JEITA ET-7501-1『ランドパターン設計に関わる表面実装部品外形図の作成指針』制定の経緯と今後の取り組み」

石橋 広行 氏 (オムロン(株))

○「電子部品のMSLによる分類と包装に関する国際規格化の取り組み」

反保 昌博 氏 (株)村田製作所

○「EU-ELV指令の動向 (はんだの適用除外規定見直しについて)」

加藤 克久 氏 (株)デンソー

○「METIプロジェクト『部品内蔵基板の設計データフォーマットの国際標準化』の取り組み状況」

春日 壽夫 氏 (基準認証イノベーション技術研究組合 (IS-INOTEK))

○「部品内蔵基板対応CAD/CAM技術と設計データフォーマットの標準化」

松澤 浩彦 氏 (株)図研

○「フロー槽材料の耐エロージョン性評価試験方法のIEC及びJIS規格化状況」

大阪大学 接合科学研究所スマートプロセス研究センター 准教授 西川 宏 氏

○「JEITAでの高温鉛入りはんだの鉛フリー化への取り組みについて」

高温鉛入りはんだ代替金属材料WG 主査 芹沢 弘二 氏

○「高温鉛入りはんだ代替材料のダイボンドへの適用可能性」

上島 稔 氏 (千住金属工業(株))

○「JEITA第2世代低銀系ソルダペースト標準品の特性」

小笠原 毅 氏 (ニホンハンダ(株))

○「SAC系はんだ接合寿命予測に関する苅谷モデルの実証実験 (その2)」

山本 剛 氏 (富士通アドバンステクノロジー(株))

○「SAC系はんだ合金の疲労き裂進展メカニズム」

芝浦工業大学 工学部 材料工学科 教授 苅谷 義治 氏